



# 产业观察-半导体：资本驱动 估值的提升



2021 年，我国半导体行业共发生投融资事件 957 起，共有 729 家企业获得各类融资。已披露融资金额的企业有 240 家，总计获得融资金额超过 764.51 亿元。其中未上市公司投融资事件有 773 起，占总投资事件的 80.7%。

从融资金额上看，资本流入最高的领域是半导体制造领域，获得融资金额约为 448.77 亿元。其中，资本集中在半导体器件细分领域，占比超过 50%，其次是半导体材料。共有 9 家企业获得 20 亿元及以上规模融资，分别是积塔半导体、地平线机器人、集创北方、紫光展锐、华灿光电、中欣晶圆、奕斯伟材料、盛合晶微、禾赛科技。

积塔半导体完成 80 亿元 A 轮融资，为全年单笔最高融资规模事件。公司成立于 2017 年，是一家特色工艺集成电路芯片制造企业，专注模拟电路、功率器件所需的特色生产工艺研发与制造，所生产的 BCD、IGBT/FRD、SGT/MOSFET、TVS、SiC 器件等芯片广泛服务于汽车电子、工业控制、电源管理、智能终端，乃至轨道交通、智能电网等高端应用市场。2018 年 1 月，上海积塔半导体特色工艺生产线项目正式立项，总投资 359 亿元，分两期完成。按照计划，项目一期规划建设月产能 6 万片 8 英寸晶圆的 0.11 $\mu$ m/0.13 $\mu$ m/0.18 $\mu$ m（微米）工艺生产线，月产能 3000 片 12 英寸特色工艺晶圆的 55nm/65nm（纳米）工艺先导生产线，以及月产能 5000 片 6 英寸晶圆的 SiC（碳化硅）化合物半导体生产线，已在 2020 年实现全面量产。

地平线机器人共完成了 C+轮至 C+++++轮共 6 轮融资，其中披露了三次融资金额分别为 4 亿美元、3.5 亿美元、超三亿美元，共计约 73.5 亿人民币 (12 亿美元)，总和为 2021 年第二高融资企业。作为全球首家基于深度学习技术的汽车智能芯片创业公司，地平线是国内做出首款车规级芯片的公司，并且已实现超过 16 万片的芯片前装出货。目前地平线已逐步实现自动驾驶芯片的大规模量产落地，正处于从芯片制造商向整车智能解决方案提供商转型的过程，其新推出的征程 5 以及天工开物平台也将助力其落实整车智能的战略。

关键词: 智能电网 机器人 碳化硅 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_37456](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37456)

